

博敏电子股份有限公司

为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 6,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 9,500 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2018 年度拟向银行申请不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，公司 2018 年预计对全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过人民币 1.2 亿元，公司接受深圳博敏担保总额不超过 1.6 亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2018 年 3 月 28 日披露的公司《关于 2018 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（临 2018-012）和 2018 年 4 月 18 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-023）。

深圳博敏因日常经营发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币 6,000 万元，期限一年，由公司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称：深圳市博敏电子有限公司

注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋、22 栋

注册资本：3300 万元

法定代表人：谢小梅

经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务；电子材料的研发、制造、销售、服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；普通货运；电子部件及整机的制造（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。

深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳博敏资产总额为 29,664.21 万元，负债总额为 16,667.54 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元、流动负债总额 16,051.61 万元，净资产为 12,996.67 万元，2017 年实现营业收入 44,409.27 万元，净利润为 277.01 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 3 月 31 日，深圳博敏资产总额为 28,627.85 万元，负债总额为 15,227.95 万元，其中银行贷款总额 5,000 万元、流动负债总额 14,632.03 万元，资产净额为 13,399.90 万元，2018 年第一季度营业收入 13,818.88 万元，净利润 403.23 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 6,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。

保证担保范围：包括但不限于主债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金，实现债权和担保权益的费用等其他款项。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信情况良好及偿还债务能力较

强，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 205,977.24 万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 207.98%；公司对控股子公司提供的担保总额为 128,985.00 万元（含公司与控股子公司之间可互相调配的额度），占公司最近一期经审计净资产的 130.24%。（未经审计、不含本次担保）

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日